













• 在某半导体材料加工中, 首先将原料放入炉中熔烧, 在某事等体材料加工中,冒充特原料放入炉中熔烧。 以除去杂质,但出炉材料有85%合格送去切片工序 继续加工,而有12%需要回炉再处理,还有3%成 为次品。在切片工序中有75%合格作为成品入库, 20%不合格但可作为原料回炉,其余5%在切片中 损失。绘制相应的GERT网络图。 0.12.N(0.1.0.01) 0.03.0.25 $\langle \hat{\mathbf{B}} \rangle$ 国炉再处理 1.0,... 3 (2) 4 A 成品 熔綻 (c) 切片不合格作为原料图外 播火 3



